

平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)



平成27年11月12日

上場会社名 株式会社アバールデータ 上場取引所 東
 コード番号 6918 URL http://www.avaldata.co.jp
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 広光 勲
 問合せ先責任者 (役職名) 管理本部担当部長 (氏名) 大関 拓夫 (TEL) 042-732-1000
 四半期報告書提出予定日 平成27年11月13日 配当支払開始予定日 平成27年12月8日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (個人投資家及びアナリスト等向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第2四半期	3,311	14.8	269	169.8	293	139.5	198	153.8
27年3月期第2四半期	2,884	3.0	99	△15.2	122	△21.0	78	△17.7

(注) 包括利益 28年3月期第2四半期 91百万円(△14.6%) 27年3月期第2四半期 107百万円(—%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
28年3月期第2四半期	30.38	30.21
27年3月期第2四半期	12.45	12.28

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
28年3月期第2四半期	10,855	9,187	78.2
27年3月期	11,102	9,130	76.0

(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 8,488百万円 27年3月期 8,434百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
27年3月期	—	5.00	—	10.00	15.00
28年3月期	—	8.00			
28年3月期(予想)			—	11.00	19.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	6,700	5.5	520	20.1	550	17.2	355	16.0	54.34

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
 新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)	28年3月期2Q	8,064,542株	27年3月期	8,064,542株
② 期末自己株式数	28年3月期2Q	1,494,576株	27年3月期	1,562,176株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	28年3月期2Q	6,532,721株	27年3月期2Q	6,280,207株

(注) 当社は、信託型従業員持株インセンティブ・プランを導入しております。当該プランにかかる従持信託が所有する当社株式数については、四半期連結財務諸表において自己株式として表示していることから、当該従持信託が所有する当社株式数については、「期末自己株式数」に、28年3月期2Qは63,500株、27年3月期は83,100株をそれぞれ含めており、「期中平均株式数 (四半期累計)」から28年3月期2Qは71,603株、27年3月期2Qは113,646株を控除しております。

なお、信託型従業員持株インセンティブ・プランの詳細については【添付資料】5ページ(3)「追加情報」に記載しております。

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については、【添付資料】4ページ(3)「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

なお、四半期決算補足説明資料は、平成27年11月12日(木曜日)に当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	5
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	5
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	5
(3) 追加情報	5
3. 四半期連結財務諸表	6
(1) 四半期連結貸借対照表	6
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	8
四半期連結損益計算書	8
四半期連結包括利益計算書	9
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	10
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	11
(継続企業の前提に関する注記)	11
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	11
(セグメント情報等)	11
4. 補足情報	13
(1) 生産、受注及び販売の状況	13

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済・金融政策などを背景に、企業収益や設備投資に改善が見られるなど、景気は緩やかな回復基調が続いております。しかしながら円安による物価上昇に伴う個人消費の弱さをはじめ、中国経済の減速や欧州経済の停滞など依然として景気の先行きは不透明なまま推移いたしました。

当社グループに関連深い半導体製造装置業界におきましては、大手半導体メーカーの次世代プロセス関連の設備投資により、半導体製造装置関連市場における需要は回復基調で推移いたしました。

このような経営環境のもと、当社グループは顧客満足度の更なる向上のために、市場ニーズを先取りした新製品の投入によりお客様の装置の競争力向上に貢献するとともに、品質面では業界水準を超える品質の確保、更に社内の業務プロセスを見直すことにより、収益性の向上に取り組みました。

この結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は3,311百万円（前年同四半期比14.8%増）、高付加価値製品の売上高増加に加え、効率的な研究開発活動を行ったことにより、営業利益は269百万円（前年同四半期比169.8%増）、経常利益は293百万円（前年同四半期比139.5%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は198百万円（前年同四半期比153.8%増）となりました。

当社グループでは、事業内容を2つの報告セグメントに分けております。当第2四半期連結累計期間におけるセグメント別の状況は次のとおりであります。

① 受託製品

当該セグメントは、半導体製造装置関連、産業用制御機器および計測機器の開発・製造・販売を行っております。半導体製造装置関連市場におきましては、大手半導体メーカーの設備投資により、概ね順調に推移いたしました。また、計測機器におきましては、各種計測機器の受注は順調に推移しております。

この結果、売上高は2,195百万円（前年同四半期比14.7%増）、セグメント営業利益は280百万円（前年同四半期比41.0%増）となりました。

当該セグメントの品目別売上の状況は次のとおりであります。

イ) 半導体製造装置関連

当該品目は、半導体製造装置の制御部を提供しております。大手半導体メーカーのLSI微細化が続く中、最先端の半導体製造装置への設備投資により、売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は1,351百万円（前年同四半期比24.0%増）となりました。

ロ) 産業用制御機器

当該品目は、各種の産業用装置、社会インフラ関連の制御部を開発・製造を行いカスタマイズ製品として提供しております。産業用装置の新規展開に加え、社会インフラ関連が好調であったため、売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は327百万円（前年同四半期比11.8%増）となりました。

ハ) 計測機器

当該品目は、各種計測機器のコントローラ、通信機器の制御部を開発・製造を行いカスタマイズ製品として提供しております。各種計測機器の受注は回復傾向にありますが、売上高はわずかに減少いたしました。

この結果、売上高は516百万円（前年同四半期比2.6%減）となりました。

② 自社製品

当該セグメントは、組込みモジュール、画像処理モジュールおよび計測通信機器の開発・製造・販売並びにこれらに付属する周辺機器およびソフトウェア等の自社製品関連商品の販売を行っております。全般的な産業用装置における設備投資は回復基調にあり、自社製品全般で順調に推移しました。

この結果、売上高は1,115百万円（前年同四半期比14.8%増）、セグメント営業利益は229百万円（前年同四半期比67.8%増）となりました。

当該セグメントの品目別売上の状況は次のとおりであります。

イ) 組み込みモジュール

当該品目は、半導体製造装置、FA全般、電力・通信関連向けに提供しております。FA全般および医療機器関連における新規受注が貢献し、売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は201百万円（前年同四半期比3.7%増）となりました。

ロ) 画像処理モジュール

当該品目は、FA全般、各種検査装置、液晶関連機器に提供しております。FA全般および液晶関連装置はまだまだ本格的な回復には至っておりませんが、新製品の立ち上がりに加え食品、医薬品などの新分野における検査装置の営業開拓が順調に進み、売上高は継続して増加いたしました。

この結果、売上高は382百万円（前年同四半期比24.4%増）となりました。

ハ) 計測通信機器

当該品目は、超高速シリアル通信モジュール「GiGA CHANNEL」シリーズ、FAXサーバ・コールセンター向けCTI (Computer Telephony Integration) ・リモート監視機器およびスマート電源装置を提供しております。

「GiGA CHANNEL」シリーズ関連は、新規検査装置向けの開拓が順調にすすみ、CTI関連も順調に推移したため、売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は421百万円（前年同四半期比12.5%増）となりました。

ニ) 自社製品関連商品

当該品目は、自社製品の販売促進とシステム販売による高付加価値化を図るため、ソフトウェアおよび付属の周辺機器を提供しております。自社製品全般の回復により、売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は109百万円（前年同四半期比16.0%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第2四半期連結会計期間末における資産は10,855百万円（前連結会計年度末比246百万円の減少）となりました。

流動資産につきましては、主に、増加要因として、現金及び預金が40百万円、たな卸資産（商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品）が46百万円、その他が主に未収入金および前払費用の増加等により12百万円、それぞれ増加となり、減少要因として、受取手形及び売掛金が68百万円、電子記録債権が67百万円、それぞれ減少となりました。この結果、36百万円減少し7,455百万円となりました。

固定資産につきましては、有形固定資産が23百万円、無形固定資産が13百万円それぞれ減少し、また、投資その他の資産が投資有価証券の時価変動の影響等により173百万円減少しております。この結果、210百万円減少し3,400百万円となりました。

(負債)

当第2四半期連結会計期間末における負債は1,668百万円（前連結会計年度末比302百万円の減少）となりました。

流動負債につきましては、主に、支払手形及び買掛金が238百万円減少、未払法人税等が60百万円増加、賞与引当金が23百万円減少、その他が未払金、未払消費税等の減少並びに前受金の増加等により21百万円減少しております。この結果、225百万円減少し1,324百万円となりました。

固定負債につきましては、長期借入金が14百万円、退職給付に係る負債が8百万円、その他が繰延税金負債の減少等により54百万円、それぞれ減少しております。この結果、77百万円減少し343百万円となりました。

なお、負債項目に記載しております、1年内返済予定の長期借入金および長期借入金は「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」によるものであります。

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産は9,187百万円（前連結会計年度末比56百万円の増加）となりました。

内訳は、利益剰余金が126百万円増加、自己株式が44百万円減少、その他有価証券評価差額金が117百万円減少、新株予約権が4百万円減少、非支配株主持分が6百万円増加したことが要因となります。なお、自己株式の減少は、ストックオプション行使による減少が32百万円、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」による減

少が12百万円となります。

(自己資本比率)

当第2四半期連結会計期間末における自己資本比率は78.2%（前連結会計年度末比2.2ポイントの増加）となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、2,422百万円（前連結会計年度末比40百万円の増加）となりました。

また、当第2四半期連結累計期間におけるフリー・キャッシュ・フローは、90百万円の増加（前年同四半期は728百万円の減少）であります。

営業活動、投資活動及び財務活動によるキャッシュ・フローの主な内容は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、116百万円の増加（前年同四半期は46百万円の増加）となりました。

主に、税金等調整前四半期純利益および減価償却費の計上、売上債権の減少等の増加要因が、仕入債務の減少、たな卸資産の増加等の減少要因を上回ったことによる増加となります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、25百万円の減少（前年同四半期は775百万円の減少）となりました。

主に、有形固定資産の取得による減少となります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、49百万円の減少（前年同四半期は0百万円の減少）となりました。

主に、自己株式の売却による収入といった増加要因を、配当金の支払、長期借入金の返済による支出等の減少要因が上回ったことによる減少となります。

なお、自己株式の売却による収入は、ストックオプション行使および「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」によるものであり、長期借入金の返済による支出は、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の予想につきましては、当社グループに関連の深い半導体製造装置業界の市況環境や需要環境の回復が遅れており予断を許しませんが、概ね計画通りに推移しており、現時点では、平成27年5月13日付「平成27年3月期決算短信」に公表いたしました数値からの変更はございません。

また今後、当社グループを取り巻く環境が著しく変化した場合等、業績に影響を及ぼす事態が生じた場合には速やかに適時開示を行います。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はございません。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年9月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成25年9月13日）等を、第1四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

(3) 追加情報

(信託型従業員持株インセンティブ・プランの会計処理について)

本プランでは、当社が信託銀行に「アパールグループ社員持株会専用信託口」（以下「従持信託」といいます。）を設定し、従持信託は、本プランを導入後6年間にわたり「アパールグループ社員持株会」（以下「本持株会」といいます。）が取得すると見込まれる規模の当社株式312,400株を予め取得いたします。その後、従持信託から本持株会に対して毎月当社の株式を売却いたします。なお、従持信託は当社株式を取得するための資金確保のため、当社保証の銀行借入を行っております。

信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額等が累積した場合には、当該株式売却益相当額等が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積した場合には、当該株式売却損相当の借入金残高について、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約書に基づき、当社が弁済することとなります。

従持信託が所有する当社株式を含む資産及び負債ならびに費用及び収益については、当社と従持信託は一体であるとし、当社の四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に含めて処理しております。これに伴い従持信託が実行した借入金残高 64,520千円（前連結会計年度末 79,130千円）を四半期連結貸借対照表に計上しております。また、従持信託が所有する株式については純資産の部に自己株式として表示しており、当四半期連結会計期間末（平成27年9月30日）における自己株式の帳簿価額及び株式数は、以下のとおりであります。

純資産の部の自己株式の帳簿価額 1,003,212千円、自己株式数 1,494,576株（前連結会計年度末 1,048,076千円、1,562,176株）。

うち、当社所有の自己株式の帳簿価額 962,445千円、自己株式数 1,431,076株（前連結会計年度末 994,726千円、1,479,076株）。

うち、従持信託所有の自己株式の帳簿価額 40,767千円、自己株式数 63,500株（前連結会計年度末 53,350千円、83,100株）。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,971,686	4,012,510
受取手形及び売掛金	1,360,816	1,292,710
電子記録債権	337,623	270,226
有価証券	10,173	10,174
商品及び製品	376,091	407,142
仕掛品	303,004	272,863
原材料及び貯蔵品	901,406	946,893
その他	230,846	242,907
流動資産合計	7,491,648	7,455,430
固定資産		
有形固定資産		
土地	1,316,699	1,316,699
その他(純額)	798,417	775,340
有形固定資産合計	2,115,117	2,092,040
無形固定資産		
投資その他の資産	89,748	76,460
投資有価証券	1,342,931	1,169,871
その他	92,402	91,502
貸倒引当金	△29,676	△29,616
投資その他の資産合計	1,405,657	1,231,757
固定資産合計	3,610,522	3,400,258
資産合計	11,102,170	10,855,688

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	949,029	710,506
1年内返済予定の長期借入金	27,000	27,000
未払法人税等	28,294	88,431
賞与引当金	266,343	242,628
役員賞与引当金	11,837	10,404
その他	267,333	245,850
流動負債合計	1,549,837	1,324,820
固定負債		
長期借入金	52,130	37,520
役員退職慰労引当金	67,502	67,502
退職給付に係る負債	71,774	63,276
その他	230,221	175,450
固定負債合計	421,628	343,749
負債合計	1,971,465	1,668,569
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,354,094	2,354,094
資本剰余金	2,444,942	2,444,942
利益剰余金	4,174,125	4,300,547
自己株式	△1,048,076	△1,003,212
株主資本合計	7,925,085	8,096,373
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	509,090	391,953
その他の包括利益累計額合計	509,090	391,953
新株予約権	10,716	6,204
非支配株主持分	685,813	692,588
純資産合計	9,130,705	9,187,118
負債純資産合計	11,102,170	10,855,688

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
売上高	2,884,787	3,311,211
売上原価	1,955,144	2,212,292
売上総利益	929,642	1,098,919
販売費及び一般管理費	829,788	829,514
営業利益	99,854	269,405
営業外収益		
受取利息	329	406
受取配当金	18,010	19,982
その他	4,694	3,832
営業外収益合計	23,034	24,222
営業外費用		
支払利息	324	221
支払手数料	127	128
営業外費用合計	451	349
経常利益	122,437	293,278
特別損失		
固定資産売却損	—	217
固定資産除却損	61	33
特別損失合計	61	251
税金等調整前四半期純利益	122,375	293,026
法人税、住民税及び事業税	10,321	80,209
法人税等調整額	33,445	3,797
法人税等合計	43,767	84,006
四半期純利益	78,608	209,020
非支配株主に帰属する四半期純利益	395	10,525
親会社株主に帰属する四半期純利益	78,213	198,494

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
四半期純利益	78,608	209,020
その他の包括利益		
其他有価証券評価差額金	28,993	△117,137
その他の包括利益合計	28,993	△117,137
四半期包括利益	107,602	91,882
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	107,207	81,357
非支配株主に係る四半期包括利益	395	10,525

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	122,375	293,026
減価償却費	61,832	60,714
賞与引当金の増減額(△は減少)	△57,251	△23,715
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△8,247	△1,433
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△8,727	△8,498
受取利息及び受取配当金	△18,339	△20,389
助成金収入	△2,256	△1,500
支払利息	324	221
固定資産除却損	61	33
固定資産売却損益(△は益)	—	217
売上債権の増減額(△は増加)	191,223	135,502
たな卸資産の増減額(△は増加)	△75,685	△46,398
未収入金の増減額(△は増加)	△4,109	△9,032
仕入債務の増減額(△は減少)	756	△240,499
未払消費税等の増減額(△は減少)	12,290	△23,713
その他	△10,512	4,820
小計	203,735	119,358
利息及び配当金の受取額	18,301	20,439
助成金の受取額	2,256	1,500
利息の支払額	△324	△221
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△177,345	△24,999
営業活動によるキャッシュ・フロー	46,623	116,076
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△1,200,000	△1,200,000
定期預金の払戻による収入	500,000	1,200,000
投資有価証券の取得による支出	△11,500	—
有形固定資産の取得による支出	△17,027	△25,874
有形固定資産の売却による収入	—	175
無形固定資産の取得による支出	△47,479	△126
その他	417	263
投資活動によるキャッシュ・フロー	△775,589	△25,561
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△14,710	△14,610
自己株式の売却による収入	76,513	35,755
配当金の支払額	△57,004	△65,492
非支配株主への配当金の支払額	△3,750	△3,750
その他	△1,593	△1,593
財務活動によるキャッシュ・フロー	△544	△49,690
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△729,511	40,825
現金及び現金同等物の期首残高	2,918,827	2,381,860
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,189,316	2,422,685

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

I 前第2四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年9月30日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	受託製品	自社製品	合計
売上高			
外部顧客への売上高	1,913,719	971,068	2,884,787
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—
計	1,913,719	971,068	2,884,787
セグメント利益	198,981	136,831	335,812

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利 益	金 額
報告セグメント計	335,812
セグメント間取引消去	—
全社費用(注)	△235,957
四半期連結損益計算書の営業利益	99,854

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

II 当第2四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年9月30日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	受託製品	自社製品	合計
売上高			
外部顧客への売上高	2,195,962	1,115,249	3,311,211
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—
計	2,195,962	1,115,249	3,311,211
セグメント利益	280,627	229,653	510,281

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利 益	金 額
報告セグメント計	510,281
セグメント間取引消去	—
全社費用(注)	△240,876
四半期連結損益計算書の営業利益	269,405

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称 及び詳細品目	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	841,512	△1.2	988,477	17.5
産業用制御機器	214,345	△4.5	251,897	17.5
計測機器	422,485	54.1	406,321	△3.8
小計	1,478,344	9.5	1,646,697	11.4
自社製品				
組込みモジュール	116,970	△14.5	125,365	7.2
画像処理モジュール	157,640	96.3	194,149	23.2
計測通信機器	173,598	△2.5	180,574	4.0
小計	448,208	13.4	500,088	11.6
合計	1,926,553	10.4	2,146,785	11.4

- (注) 1 金額は製造原価にて表示しております。
 2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
 3 自社製品セグメントにおいては、記載した詳細品目に付属する周辺機器の提供として、自社製品関連商品の販売を行っておりますが、当該仕入実績は、② 商品仕入実績として別途記載しております。

② 商品仕入実績

セグメントの名称 及び詳細品目	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
自社製品				
自社製品関連商品	75,742	△12.9	96,557	27.5
合計	75,742	△12.9	96,557	27.5

- (注) 1 金額は仕入価格にて表示しております。
 2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

③ 受注状況及び販売状況

イ) 受注高

セグメントの名称 及び詳細品目	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	1,066,916	△26.4	1,157,224	8.5
産業用制御機器	260,513	△29.6	390,597	49.9
計測機器	440,641	17.9	538,127	22.1
小計	1,768,071	△19.4	2,085,949	18.0
合計	1,768,071	△19.4	2,085,949	18.0

ロ) 受注残高

セグメントの名称 及び詳細品目	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	232,660	△49.0	264,570	13.7
産業用制御機器	127,469	△28.3	269,811	111.7
計測機器	116,430	△37.7	289,242	148.4
小計	476,560	△42.0	823,624	72.8
合計	476,560	△42.0	823,624	72.8

ハ) 販売実績

セグメントの名称 及び詳細品目	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	1,089,955	△8.4	1,351,195	24.0
産業用制御機器	293,249	△6.6	327,835	11.8
計測機器	530,515	60.8	516,930	△2.6
小計	1,913,719	4.4	2,195,962	14.7
自社製品				
組込みモジュール	194,817	△17.6	201,981	3.7
画像処理モジュール	307,545	42.4	382,590	24.4
計測通信機器	374,495	△11.2	421,370	12.5
自社製品関連商品	94,209	△0.0	109,306	16.0
小計	971,068	0.3	1,115,249	14.8
合計	2,884,787	3.0	3,311,211	14.8

(注) 1 金額は販売価格にて表示しております。

2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

3 受注及び受注残高は受託製品セグメントの内容であり、自社製品セグメントにおいては、需要予測に基づく見込生産を行っているため、該当事項はありません。